



2025年12月11日

芝浦メカトロニクス株式会社

次世代半導体パッケージ向けパネル用ウェットスピノ装置「PD-series」を開発

芝浦メカトロニクス株式会社は、このたび次世代半導体パッケージ向けに、高清浄度洗浄やエッティングなど各種ウェットプロセスに適用可能なパネル用スピノ装置「PD-series」を開発しました。

本製品は、大型の角型ワークを用いてサーバーや生成AIに使用されるGPU/CPUの2.XD製品を製造する際、大型の角型ワークに対しウェーハレベルの高度かつ高性能なウェット処理を実現する新シリーズです。

次世代半導体パッケージの製造工程では、角型・大型の有機基板、ガラス、シリコンなど多様な材料に対する高度な洗浄・エッティング技術が必要とされています。

「PD-series」は、こうしたニーズに応えるため、当社が培ってきた洗浄技術やエッティング技術を、次世代半導体パッケージに対応する大型パネル向けに展開すべく開発した設備となります。半導体前工程・後工程、フラットパネルディスプレイ前工程・後工程向けの製造装置を手掛けてきた当社の強みを活かした製品です。

次世代半導体パッケージ向け

パネル用ウェットスピノ装置

「PD-series」



■ 製品 次世代半導体パッケージ向けパネル用ウェットスピノ装置「PD-series」

■ 特長

- ・多様なワークに対応（サイズ：□300～□600mm 他 材料：有機基板、ガラス、シリコン等）
- ・ウェーハ前工程レベル × 大型の角型ワークのプロセス技術を搭載
- ・開発から研究までカバーする柔軟なユニット構築、量産展開に対応

【お問い合わせ先】

芝浦メカトロニクス株式会社

ファインメカトロニクス事業部

<https://www.shibaura.co.jp/inquiry/index.html>